

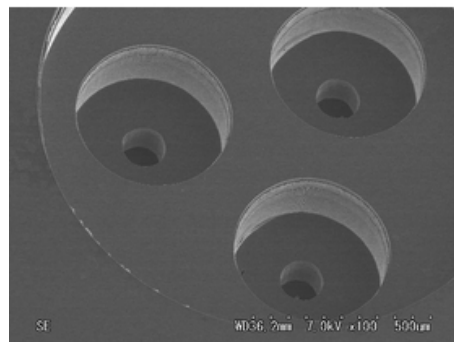
富士電機（株）



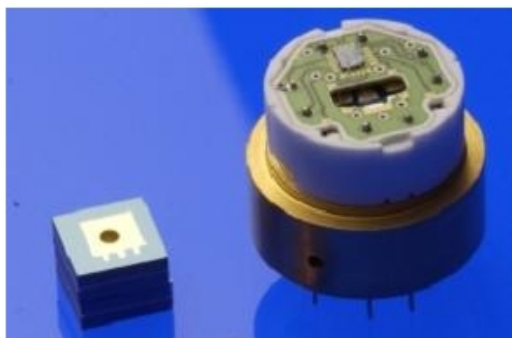
MEMSファウンドリーサービス

Si、SOI基板への複雑な3次元形状加工を実現

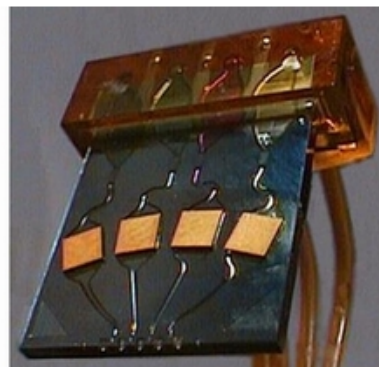
ラージギャップ露光、高段差レジストコート、高アスペクト比加工の各技術を駆使し、基板同一面への多段加工を高精度に実現します。  
MEMS加工時に制約のあるウエハに対して複雑な3次元形状加工を実現可能です。  
また、組成比、膜厚を管理した各種メタル膜の成膜も実施いたします。



圧力センサ・ヘッド



インクジェットヘッド



オートアイライナ



ICPEッチャ

